

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司签订投资意向书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的投资意向书为意向性协议，具体投资事项需双方另行签订协议或合同，且须履行公司相关决策审批程序后方可生效和实施。若投资具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致协议部分或全部内容无法履行的风险，因此本次投资意向尚存在不确定性。

2、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、意向书签署概况

近日，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州信越半导体有限公司（以下简称“苏州信越”或“目标公司”）及其全体股东签署了《投资意向书》，公司拟使用自有资金不超过4,000万元人民币向目标公司投资，本次投资完成后，公司占目标公司10%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次签订的为投资意向性协议，投资意向书的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：苏州迈达升半导体材料合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320507MA27CH2P6X

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 11 月 04 日

执行事务合伙人：江欣怡

主要经营场所：江苏省苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 7 幢三楼

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司名称：苏州扬启佳半导体材料合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320507MA27CH21XE

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 11 月 04 日

执行事务合伙人：江欣怡

主要经营场所：江苏省苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 7 幢四楼

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、公司名称：苏州申特远半导体材料合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320507MABWBUKR6Y

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 08 月 10 日

执行事务合伙人：董文强

主要经营场所：江苏省苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 号楼二楼
8210-40

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、公司名称：无锡东上冠辰功率半导体合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320205MA7F91HP8M

企业类型： 有限合伙企业

成立日期：2022 年 01 月 20 日

执行事务合伙人：无锡禾信新能源技术有限公司(委派代表 陆智超)

主要经营场所：无锡市锡山区东亭街道二泉东路 100 号第一层

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、姓名：路云峰

身份证号码： 41282419810720*****

住所： 上海市松江区弘翔路 556 号*****

6、姓名：茅凤英

身份证号码： 31010419560617*****

住所： 上海市徐汇区茶陵路 75 弄*****

上述交易对手方及其现有股东与公司及公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，上述交易对手方全体股东不属于失信被执行人。

三、目标公司基本情况

公司名称：苏州信越半导体有限公司

统一社会信用代码：91320507MA275QDC6D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2021 年 09 月 29 日

法定代表人：邓永议

注册地址：苏州市相城区太平街道蠡太路 88 号 1#厂房

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、投资意向书主要内容

本《投资意向书》（以下简称“意向书”）由无锡洪汇新材料科技股份有限公司及/或其关联方（以下简称“洪汇新材”或“投资人”）、原股东（定义见下文）以及公司（定义见下文）于【2023】年【1】月【3】日签订。本意向书列明了投资人拟对公司进行投资之交易的主要商业条款，反映了对各方意向的讨论，其他交易条件及条款最终将以各方正式达成并签署的交易文件约定为准。本意向书在任何情况下均不构成投资人投资的承诺。

条款名称	条款内容
公司	苏州信越半导体有限公司，公司及其子公司和附属公司合称为“集团公司”。
原股东	苏州迈达升半导体材料合伙企业（有限合伙）； 苏州扬启佳半导体材料合伙企业（有限合伙）； 苏州申特远半导体材料合伙企业（有限合伙）； 无锡东上冠辰功率半导体合伙企业（有限合伙）； 路云峰，身份证号/护照号[41282419810720****]； 茅凤英，身份证号/护照号[31010419560617****]（合称“原股东”）。
投资人	无锡洪汇新材料科技股份有限公司及/或其关联方。

公司投后估值	公司的投资后估值不高于人民币 4 亿元。
投资金额及股本结构	投资人拟向公司投资人民币 4000 万元。 本轮投资交割之前和之后的公司股权结构见附录 A。
主营业务	公司主要从事【半导体器件专用设备、光电子器件、半导体器件专用设备生产和销售业务】。
投资款用途	投资人的投资款主要用于公司采购分子束外延炉设备、项目建设以及补充流动资金。
尽职调查	投资人有权自行或委托第三方对公司进行尽职调查。公司及原股东应向投资人及其委托的第三方充分开放信息并提供资料。如有必要，投资人有权聘请资产评估公司对公司进行评估。
保密	本意向书中所载明的任何条款，包括本意向书存在的事实及任何与此相关的谈判讨论，应被视为保密信息，除取得其他方事先书面同意，或者法律另有要求，或者按照监管部门要求进行披露外，不得向任何第三方披露。如任何一方违反本条款，违约方应向守约方赔偿其已产生的与本次交易相关费用的五倍金额或人民币【100】万元（孰高者）。
排他性	在本意向书签署后【90】日内，未经投资人事先书面同意，公司不会且应使其股东、董事、员工、代表以及其他相关方不会直接或间接的采取任何行动以发起、寻求、提议、参加与投资人以外的任何第三方就公司股权/债权融资、股权或股权相关证券的发行而进行的磋商、谈判或者就此订立任何协议或安排。如果公司或原股东在此排他期内收到第三方的此类请求，应立即通知投资人。
费用	各方各自承担本次交易中产生的费用和成本。
争议解决	本意向书应受中华人民共和国法律的管辖。因本意向书所产生的或与之相关的任何争议，应提交投资人注册地人民法院通过诉讼方式解决。
非约束性	本意向书列明了投资人拟对公司进行投资之交易的主要商业条款，除标题为“尽职调查”、“保密”、“排他性”、“争议解决”、“费用”和“非约束性”之条款外，本意向书的其他条款对各方均无法律约束力。
附则	本意向书经投资方、与公司、公司原股东签署后即可生效。 本意向书一式【八】份，各方持有一份，具有同等法律效力。

附录 A

1、本轮投资交割之前的公司股权结构

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州迈达升半导体材料合伙企业（有限合伙）	3,825.00	76.50
2	苏州扬启佳半导体材料合伙企业（有限合伙）	500.00	10.00
3	路云峰	250.00	5.00
4	苏州申特远半导体材料合伙企业（有限合伙）	225.00	4.50

5	茅凤英	100.00	2.00
6	无锡东上冠辰功率半导体合伙企业（有限合伙）	100.00	2.00
总计		5000.00	100.00

2、本轮投资交割之后的公司股权结构

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州迈达升半导体材料合伙企业（有限合伙）	3,825.0000	68.85
2	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	555.5556	10.00
3	苏州扬启佳半导体材料合伙企业（有限合伙）	500.0000	9.00
4	路云峰	250.0000	4.50
5	苏州申特远半导体材料合伙企业（有限合伙）	225.0000	4.05
6	茅凤英	100.0000	1.80
7	无锡东上冠辰功率半导体合伙企业（有限合伙）	100.0000	1.80
总计		5555.5556	100.00

五、对公司的影响

本次签订的投资意向书符合公司的未来资本发展规划，通过参股、控股等方式进行适当的资本运作，实现资源共享，优化公司产业布局，提升公司盈利和核心竞争力，促进公司的长期持续发展；符合公司整体发展战略及全体股东利益。

本次对外投资使用自有资金，投资金额及投资风险整体可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本投资意向书为双方推进合作事项而签署的意向协议，具体投资事项需双方另行签订协议或合同，且须履行公司相关决策审批程序后方可生效和实施。若投资具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致协议部分或全部内容无法履行的风险，因此本次投资意向尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本投资意向书涉及的投资金额、目标公司投后估值等数值均为计划数或

预估数，存在不确定性，不代表公司对投资者的承诺。

3、截至本公告日，各方尚未开展具体合作事宜，本投资意向书的签订预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。

4、截止本公告日，公司未曾涉及半导体行业，公司主营业务仍为氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。

5、公司前期就该项投资的前景进行了一定的尽职调查，在具体投资事项需双方另行签订协议或合同前，将进一步进行详细的尽职调查，必要时，聘请资产评估公司对目标公司进行评估；但在实际投资过程中仍不能排除产业政策、行业竞争、市场开拓、经营管理等方面带来的不确定性，存在投资收益不确定和投资本金亏损的风险。公司将密切与其他股东的沟通，加强对市场需求的判研和机遇把握，以不断适应其发展要求及市场变化，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

6、公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定，根据后续合作情况，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。

七、其他说明

1、公司近三年披露的签订意向性协议情况

(1) 2021年1月，公司设立完成控股子公司深圳市汇朗朗医疗投资有限公司；2021年3月17日，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司分别与王霞、周杰、刘中良（统称为“乙方”）就乙方分别持有的口腔门诊机构未来收并购合作分别签订了《合作意向书》。具体内容详见公司于2021年3月18日在指定媒体披露的《关于控股子公司签订合作意向书的公告》（公告编号：2021-009）。

(2) 2021年3月25日，深圳市汇朗朗医疗投资有限公司分别与王宇、王霞、杨晓霞、郝国强、邵广军（统称为“乙方”）就乙方分别持有的口腔门诊机构未来收并购合作分别签订了《合作意向书》，具体内容详见公司于2021年

3月26日在指定媒体披露的《关于控股子公司签订合作意向书的公告》（公告编号：2021-010）；

2021年11月17日，公司与朗朗医疗投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司将深圳市汇朗朗医疗投资有限公司51%股权转让给朗朗医疗投资有限公司，本次股权转让完成后，公司不再持有汇朗朗的股权，上述转让于2021年12月6日完成了工商变更。具体内容详见公司于2021年11月18日、2021年12月7日在指定媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）、《关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-089）。

2、本次投资意向书签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况未发生变动；未来三个月内除董事李专元、高管岳希朱有部分2019年限制性股票激励计划剩余未解锁的限制性股票解除限售外，暂未收到公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若发生相关减持等权益变动事项，公司将会严格按照法律法规相关要求履行信息披露义务。

八、备查文件

《投资意向书》

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日